



2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年8月14日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス
コード番号 6890 URL <https://www.ferrotec.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢
問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無： 無
決算説明会開催の有無： 無

(百万円未満切捨)

1. 2025年3月期第1四半期の連結業績（2024年4月1日～2024年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第1四半期	61,110	16.9	7,015	△1.4	8,217	7.7	4,849	11.6
2024年3月期第1四半期	52,261	20.5	7,113	△8.7	7,628	△25.2	4,346	△40.9

(注) 包括利益 2025年3月期第1四半期 20,567百万円 (98.4%) 2024年3月期第1四半期 10,367百万円 (△37.6%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第1四半期	103.16	90.75
2024年3月期第1四半期	92.64	91.42

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2025年3月期第1四半期	552,728	299,402	39.4	4,635.52
2024年3月期	510,026	278,166	40.1	4,348.01

(参考) 自己資本 2025年3月期第1四半期 217,955百万円 2024年3月期 204,409百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年3月期	—	50.00	—	50.00	100.00
2025年3月期	—	—	—	—	—
2025年3月期（予想）	—	50.00	—	50.00	100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 2025年3月期の連結業績予想（2024年4月1日～2025年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期（累計）	120,000	13.8	13,000	△0.3	14,500	△4.7	8,500	1.3	180.78
通期	235,000	5.7	26,000	4.5	26,000	△2.0	16,000	5.6	340.29

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更： 無
新規 ー社 (社名) ー、除外 ー社 (社名) ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

(注) 詳細は、添付資料 8 ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料 8 ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (会計方針の変更に関する注記)」をご覧ください。

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

2025年3月期1Q	47,117,949株	2024年3月期	47,111,567株
2025年3月期1Q	99,365株	2024年3月期	99,365株
2025年3月期1Q	47,014,376株	2024年3月期1Q	46,916,822株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー： 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料 3 ページ「1. 経営成績等の概況 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)	8
(会計方針の変更に関する注記)	8
(追加情報)	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
(セグメント情報等の注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間における経営環境については、米国景気は個人消費や非製造業を中心に堅調ながら拡大ペースも緩やかになっており、利下げの観測も出ております。欧州景気は昨年末の不振から持ち直し緩やかに回復しております。日本はインバウンド増加、雇用賃金情勢の改善もあり概ね景気は堅調であり、金融政策もマイナス金利の解除以降、利上げの方向に向かっています。中国は個人消費や輸出で回復が見られるなど景気改善が見られますが一進一退の状況であり、住宅や不動産の市況低迷が続くこともあり、金融緩和措置が続いております。

為替相場は、対米ドルレートは年初以降円安方向に進みました。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、昨年の半導体デバイスの在庫調整局面から徐々に回復、半導体製造装置の需要も回復が見られました。昨年需要の下支えをした中国ローカルメーカーからの需要が堅調ななか、欧米系メーカーからの需要が徐々に回復しております。パワー半導体市場についても比較的堅調に推移しています。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業では、製造装置向けの真空部品や金属受託加工が回復、半導体製造プロセス向けの各種マテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）や部品洗浄も工場稼働率の改善を受け緩やかに増加しております。

電子デバイス等の事業では、サーモモジュールが通信分野を中心に堅調、パワー半導体用基板も、産業機器向けの販売を伸ばしております。

なお、経常利益は営業外損益の為替差益、補助金収入の増もあり前年同期比で増加しました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は61,110百万円（前年同期比16.9%増）、営業利益は7,015百万円（前年同期比1.4%減）、経常利益は8,217百万円（前年同期比7.7%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は4,849百万円（前年同期比11.6%増）となりました。

当第1四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

なお、当第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。以下の前年同期比較については、変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。詳細は、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等の注記）」に記載しております。

（半導体等装置関連事業）

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンパーツ、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

半導体全体及び半導体製造装置の需要が回復基調のなか、当社の真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品は前年同期比で大きく回復しました。半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品も石英製品・セラミックス製品を中心に売上を伸ばしました。部品洗浄サービスも、工場稼働率の回復を背景に売上を伸ばしました。石英坩堝については前年同期比で太陽光パネル製造メーカー向け出荷が増加したことにより増収となりました。

この結果、当該事業の売上高は39,926百万円（前年同期比33.6%増）、営業利益は4,538百万円（前年同期比10.3%増）となりました。

（電子デバイス事業）

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体、センサです。

サーモモジュールは、5G用の移動通信システム機器向けや光トランシーバー向けを中心に売上を伸ばしました。パワー半導体用基板についても、産業機械向け等で順調に売上を伸ばしました。また、センサの損益は株式会社大泉製作所の決算期変更により9カ月決算となるため当第1四半期連結累計期間に含まれておりません。

この結果、当該事業の売上高は9,951百万円（前年同期比8.7%増）、営業利益は1,930百万円（前年同期比12.9%増）となりました。

(車載関連事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、センサです。

サーモモジュールは、前年同期比で自動車温調シート向けの販売を伸ばしました。パワー半導体用基板は、DCB基板での競争激化の影響によりやや減収となりました。また、センサの損益は株式会社大泉製作所の決算期変更により9カ月決算となるため当第1四半期連結累計期間に含まれておりません。

この結果、当該事業の売上高は5,841百万円（前年同期比21.2%減）、営業利益は730百万円（前年同期比57.4%減）となりました。

(その他)

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

工作機械は前年同期比で増収となりましたが、太陽電池用シリコン製品の出荷が減少し、部門全体では減収となりました。

当該事業の売上高は5,391百万円（前年同期比7.4%減）、営業損失は101百万円（前年同期は営業損失80百万円）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

<資産>

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ42,701百万円増加し、552,728百万円となりました。これは主に受取手形、売掛金及び契約資産14,577百万円、有形固定資産17,584百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ21,465百万円増加し、253,326百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金5,292百万円、長期借入金（1年内返済予定を含む）13,323百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ21,236百万円増加し、299,402百万円となりました。これは主に利益剰余金2,499百万円、為替換算調整勘定11,225百万円、非支配株主持分7,689百万円の増加によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2024年5月15日の「2024年3月期決算短信」で公表いたしました第2四半期連結累計期間の業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「連結業績予想（第2四半期累計期間）の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	117,254	117,970
受取手形、売掛金及び契約資産	61,940	76,518
商品及び製品	18,092	17,602
仕掛品	12,875	15,355
原材料及び貯蔵品	25,942	29,524
その他	12,615	15,137
貸倒引当金	△312	△350
流動資産合計	248,408	271,758
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	66,583	87,209
機械装置及び運搬具（純額）	59,533	67,799
工具、器具及び備品（純額）	7,468	7,843
土地	4,660	4,668
リース資産（純額）	12,018	14,155
建設仮勘定	51,075	37,246
有形固定資産合計	201,339	218,924
無形固定資産		
のれん	2,010	2,000
その他	4,600	4,673
無形固定資産合計	6,611	6,674
投資その他の資産		
関係会社株式	32,944	33,335
その他	21,421	22,770
貸倒引当金	△699	△734
投資その他の資産合計	53,666	55,371
固定資産合計	261,618	280,970
資産合計	510,026	552,728

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	38,334	43,627
電子記録債務	3,967	4,149
短期借入金	26,454	27,516
1年内償還予定の社債	3,763	3,763
1年内返済予定の長期借入金	17,259	16,860
未払法人税等	2,128	2,057
賞与引当金	3,549	3,232
その他	26,691	27,583
流動負債合計	122,148	128,790
固定負債		
社債	320	320
転換社債型新株予約権付社債	25,000	25,000
長期借入金	62,364	76,087
退職給付に係る負債	1,802	1,786
資産除去債務	402	398
その他	19,822	20,942
固定負債合計	109,712	124,535
負債合計	231,860	253,326
純資産の部		
株主資本		
資本金	29,539	29,549
資本剰余金	68,305	68,454
利益剰余金	79,881	82,380
自己株式	△89	△89
株主資本合計	177,638	180,295
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,254	912
為替換算調整勘定	25,316	36,541
退職給付に係る調整累計額	200	204
その他の包括利益累計額合計	26,771	37,659
非支配株主持分	73,756	81,446
純資産合計	278,166	299,402
負債純資産合計	510,026	552,728

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
売上高	52,261	61,110
売上原価	34,637	42,831
売上総利益	17,623	18,278
販売費及び一般管理費	10,510	11,263
営業利益	7,113	7,015
営業外収益		
受取利息	406	503
補助金収入	642	1,517
為替差益	142	690
その他	338	208
営業外収益合計	1,530	2,919
営業外費用		
支払利息	383	545
持分法による投資損失	465	1,092
その他	166	79
営業外費用合計	1,015	1,717
経常利益	7,628	8,217
特別利益		
投資有価証券売却益	—	1
持分変動利益	13	2
特別利益合計	13	3
特別損失		
投資有価証券評価損	489	—
特別損失合計	489	—
税金等調整前四半期純利益	7,152	8,221
法人税等	1,638	1,871
四半期純利益	5,514	6,349
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,167	1,499
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,346	4,849

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
四半期純利益	5,514	6,349
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	112	△341
為替換算調整勘定	3,931	13,014
退職給付に係る調整額	63	4
持分法適用会社に対する持分相当額	746	1,541
その他の包括利益合計	4,853	14,217
四半期包括利益	10,367	20,567
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	7,790	15,864
非支配株主に係る四半期包括利益	2,576	4,703

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更に関する注記)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。

法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前年四半期の四半期連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

(追加情報)

(連結子会社の事業年度等に関する事項の変更)

従来、連結子会社のうち決算日または仮決算日が3月31日であった大泉製作所及びその子会社4社は、当社グループの予算編成及び業績管理等、事業運営の効率化を図るため、当第1四半期連結会計期間より、決算日を12月31日に変更しております。四半期連結財務諸表の作成に当たっては、決算日が12月31日である1社は、従来、四半期連結決算日で実施した仮決算に基づく四半期財務諸表を使用しておりましたが、決算日を12月31日に変更した4社を含め、四半期決算日(3月31日)現在の四半期財務諸表を使用し、四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行う方法に変更しております。

この変更により、当第1四半期連結累計期間において、当該連結子会社5社の損益は含まれておりません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
減価償却費	3,817百万円	5,072百万円
のれんの償却額	94	10

(セグメント情報等の注記)

I 前第1四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	車載関連 事業	計				
売上高								
(1)外部顧客への 売上高	29,874	9,156	7,408	46,440	5,821	52,261	—	52,261
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	29,874	9,156	7,408	46,440	5,821	52,261	—	52,261
セグメント利益 又は損失(△)	4,115	1,709	1,715	7,540	△80	7,460	△346	7,113

(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△346百万円には、セグメント間取引の消去250百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用96百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自2024年4月1日至2024年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	車載関連 事業	計				
売上高								
(1)外部顧客への 売上高	39,926	9,951	5,841	55,718	5,391	61,110	—	61,110
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	39,926	9,951	5,841	55,718	5,391	61,110	—	61,110
セグメント利益 又は損失(△)	4,538	1,930	730	7,198	△101	7,097	△82	7,015

(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△82百万円には、セグメント間取引の消去△2百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用85百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

当第1四半期連結会計期間より、当社グループ内の業績管理区分の一部見直しに伴い、従来「電子デバイス事業」に含まれていた車載向けのサーモモジュール、パワー半導体用基板、センサ製品を「車載関連事業」として記載する方法に変更しております。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第1四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。